



i n v e n t

ハードウェア リファレンス ガイド hpワークステーションxw6000

製品番号 : 301155-291

2002年10月

このガイドは、リファレンス マニュアルとして作成されています。このガイドでは、お使いのワークステーションに固有の機能と、ハードディスク ドライブ、メモリ、拡張ボード、プロセッサなどのコンポーネントを増設する手順について説明します。

© 2002 Hewlett-Packard Company
© 2002 日本ヒューレット・パッカード株式会社

HPおよびHPロゴは、Hewlett-Packard Companyの商標です。

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、現状有姿のままで提供されるもので、いかなる保証も含みません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品に対する保証は、当該製品に付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。



警告：その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



注意：その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

ハードウェア リファレンス ガイド
hpワークステーションxw6000
初版 2002年10月
製品番号：301155-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社

目次

1 ワークステーションの機能	
標準構成の機能	1-1
フロントパネルの各部	1-2
リアパネルの各部	1-3
システムボードの各部	1-4
システムボードの各部（続き）	1-5
オーディオシステム	1-6
キー ボード	1-7
イージーアクセスソフトウェア	1-8
Windowsロゴキー	1-9
マウス	1-10
シリアル番号の記載位置	1-10
ミニタワー構成からデスクトップ構成への変更	1-10
デスクトップ構成からミニタワー構成への変更	1-14
2 ハードウェアのアップグレード	
取り付け手順の概要	2-1
ワークステーションのアクセスパネルの取り外し	2-3
フロントパネルの取り外し	2-4
システムメモリの増設	2-5
DIMMソケットの位置	2-5
DIMMの取り付け	2-6
DIMMの取り付け	2-8
ドライブの増設	2-9
ドライブベイのコンポーネント	2-9
ドライブを取り付けるための準備	2-12
ハードディスクドライブの取り付け	2-14
ドライブの取り外し	2-17
拡張ボードの取り付けおよび取り外し	2-20
AGPソケットおよびPCIソケットの位置	2-20
拡張ボードの取り付け	2-21
拡張ボードの取り外し	2-22
プロセッサの増設	2-23
プロセッサのアップグレード	2-27
プロセッサをアップグレードする際の準備	2-27
既存のプロセッサの取り外し	2-30
新しいプロセッサの取り付け	2-32

A 仕様	
B ハードディスク ドライブの取り付け	
Ultra ATAデバイスのケーブルセレクト機能	B-1
Ultra ATAデバイスの取り付けのガイドライン	B-2
SCSIデバイス	B-3
SCSIデバイスのガイドライン	B-3
SCSIデバイスの取り付けのガイドライン	B-5
SCSIコントローラ	B-6
SCSIケーブルの使用	B-6
SCSIデバイスと[SCSISelect]の使用	B-7
C バッテリの交換	
バッテリの交換	C-1
D セキュリティ ロック	
ワーカステーションの固定	D-1
E 静電気対策	
静電気による損傷の防止	E-1
アースの方法	E-2
F ワーカステーションの手入れと運搬時の注意	
ワーカステーションの手入れ	F-1
CD-ROM ドライブの使用上の注意	F-2
操作および取り扱いに関する注意	F-2
クリーニングの際の注意	F-2
安全にお使いいただくためのご注意	F-2
運搬時の注意	F-3

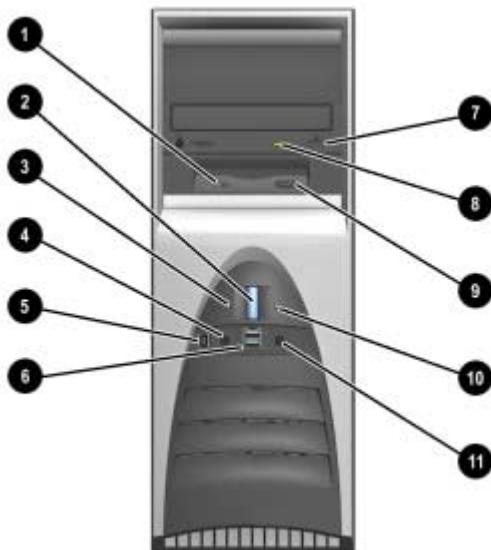
索引

ワークステーションの機能

標準構成の機能

HPワークステーションxw6000はミニタワー構成ですが、デスクトップ構成に簡単に変えることができます。ワークステーションの機能は、モデルにより異なる場合があります。お使いのワークステーションのハードウェアおよびソフトウェアの一覧を表示するには、[Diagnostics for Windows] ユーティリティまたはシステム情報の参照 (INSPECT) ユーティリティ（一部のモデルで使用可能）を実行してください。これらのユーティリティの使用手順については、Documentation Library CDに収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。

フロントパネルの各部



フロントパネルの各部

① ディスクット ドライブ ランプ ⑦ CD-ROM取り出しボタン

② デュアル ステート電源ボタン ⑧ CD-ROM ドライブ ランプ

③ 電源ランプ ⑨ ディスクット取り出しボタン

④ ヘッドフォン コネクタ ⑩ ハードディスク ドライブ ランプ

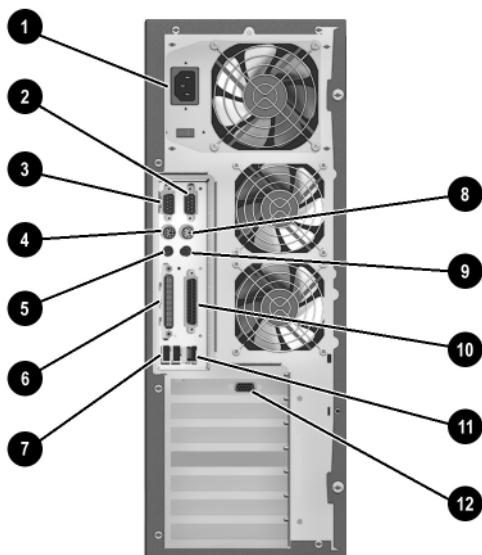
⑤ 1394コネクタ (オプション) *

⑪ マイク コネクタ

⑥ USBコネクタ

* お使いのワークステーションには1394コネクタが装備されています。このコネクタは、別売の1394 PCI拡張ボードが取り付けられている場合にのみ機能します。

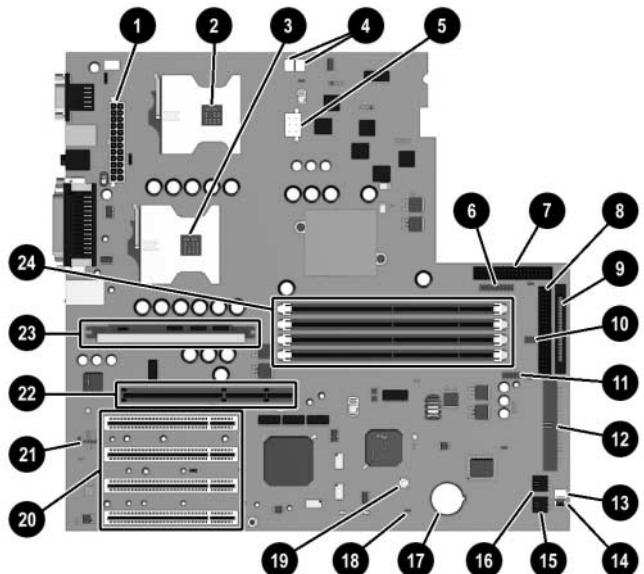
リア パネルの各部



リア パネルの各部

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| ① 電源コード コネクタ | ⑦ USBコネクタ |
| ② シリアルコネクタ (シリアルA) | ⑧ マウス コネクタ |
| ③ シリアルコネクタ (シリアルB) | ⑨ マイク/ラインイン コネクタ |
| ④ キーボードコネクタ | ⑩ パラレルコネクタ |
| ⑤ ヘッドフォン/ラインアウトコネクタ | ⑪ NIC (ネットワーク インタフェース カード)
コネクタ |
| ⑥ SCSIコネクタ | ⑫ VGA (AGP) ビデオコネクタ |

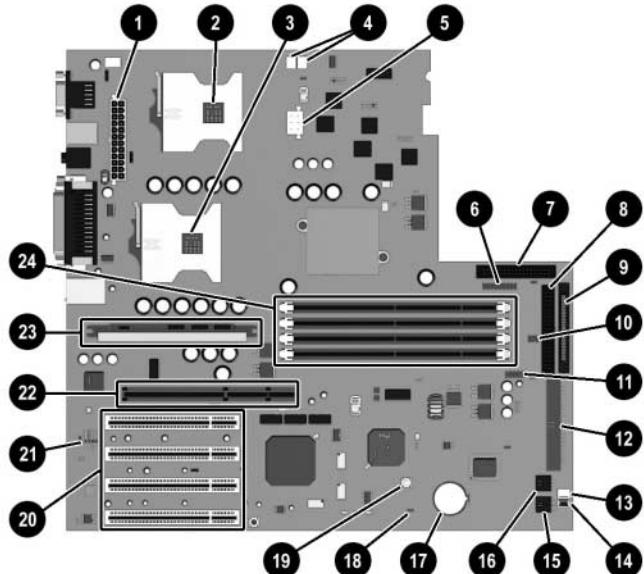
システム ボードの各部



システム ボードの各部

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ① 24ピン電源コネクタ | ⑨ SCSIコネクタ |
| ② プライマリ プロセッサ ソケット | ⑩ カバー センサ コネクタ |
| ③ セカンダリ プロセッサ ソケット | ⑪ フロントUSBコネクタ |
| ④ リア システム ファン コネクタ | ⑫ セカンダリATAコネクタ |
| ⑤ CPU電源コネクタ | ⑬ フロント シャーシ ファン コネクタ |
| ⑥ 電源ボタン ヘッダ | ⑭ 内蔵スピーカ コネクタ |
| ⑦ ディスクケット ドライブ コネクタ | ⑮ CD-ROMオーディオ スイッチ |
| ⑧ プライマリATAコネクタ | ⑯ 補助オーディオ コネクタ |

システム ボードの各部（続き）



システム ボードの各部

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ⑰ バッテリ | ⑲ フロントオーディオコネクタ |
| ⑯ パスワード ヘッダ | ㉑ AGP Pro ソケット |
| ⑰ CMOSリセット スイッチ | ㉒ セカンダリ プロセッサ電圧調整モジュール (VRM) |
| ㉓ PCIスロット (×4) | ㉔ DIMMメモリ ソケット (×4) |

オーディオ システム

お使いのワークステーションには、アナログまたはデジタルの外部ステレオスピーカをサポートする、統合的なオーディオソリューションが用意されています。このシステムには、スピーカの種類を自動的に感知し、適切な信号を出力する機能があります。自動感知機能は、モノラルコネクタがラインアウトコネクタに差し込まれているかどうかを検出して実行されます。

ステレオ用コネクタ付きのデジタルスピーカを使用し、システムをデジタル方式に自動的に切り換わるようにする場合は、自動感知機能が動作するよう、ステレオ/モノラルアダプタを使用する必要があります。ただし、ステレオ/モノラルアダプタがない場合は、オーディオ信号をアナログからデジタルに手動で切り換えることもできます。お使いのオペレーティングシステムでオーディオ信号を手動で切り換える方法については、Documentation Library CDに収録されている『トラブルシューティングガイド』の「オーディオに関するトラブルの解決方法」を参照してください。

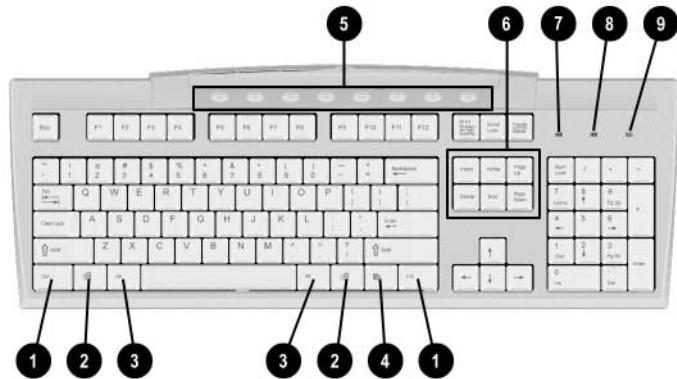
モノラルのヘッドフォンセットをお使いの場合は、システムによってデジタル方式に切り換えられますが、そのときに雑音が発生するか、無音状態になります。この場合、手動で信号をアナログに切り換えると、これらのトラブルを解消できます。お使いのオペレーティングシステムでオーディオ信号を手動で切り換える方法については、Documentation Library CDに収録されている『トラブルシューティングガイド』の「オーディオに関するトラブルの解決方法」を参照してください。



お使いのアナログスピーカまたはヘッドフォンが機能しない場合は、自動感知機能をオンにしたままモノラルアダプタを使用していないかを確認してください。

キーボード

お使いのワークステーションには、イージー アクセス キーボードが付いています。次の図に、キーボードランプと特殊なファンクションキーの位置を示します。



イージー アクセス キーボードの各部の名称

イージー アクセス キーボード

番号	名称	機能
①	[Ctrl]キー	別のキーと組み合わせて使用します。この機能は、ご使用のアプリケーション ソフトウェアによって異なります
②	Windowsロゴ キー	他の機能を実行するために他のキーと組み合わせて使用します（この項の「Windowsロゴ キー」を参照してください）
③	[Alt]キー	別のキーと組み合わせて使用します。この機能は、ご使用のアプリケーション ソフトウェアによって異なります
④	アプリケーション キー*	マウスの右ボタンと同様に Microsoft® Office アプリケーション内でポップアップ メニューを表示するために使用します。また、他のソフトウェア アプリケーションで別の機能を実行することもできます
⑤	イージー アクセス キー	頻繁に使用するWebサイト、アプリケーション、およびサービスに素早く簡単にアクセスできるようにします

*特定の国や地域でのみ使用可能です。

イージー アクセス キーボード（続き）

番号	名称	機能
⑥	編集キー	[Insert]、[Home]、[Page Up]、[Delete]、[End]および[Page Down]の各キーがあります  [Ctrl]+[Alt]+[Delete]キーを押すと、コンピュータを再起動できます
⑦	[Num Lock]ランプ	Num Lock機能が有効かどうかを示します
⑧	[Caps Lock]ランプ	Caps Lock機能が有効かどうかを示します
⑨	[Scroll Lock]ランプ	Scroll Lock機能が有効かどうかを示します

イージー アクセス ソフトウェア

お使いのイージー アクセス キーボード ボタンの割り当ては、デフォルトに設定されています。お使いのワークステーションにプリインストールされているイージー アクセス ソフトウェアを使用して、イージー アクセス ボタンの割り当てをユーザの使用目的に合わせて変更することができます。各ボタンは、選択した任意のプログラムやサービス、または任意のWebサイト（URL）に合わせて再度割り当てることができます。

イージー アクセス ボタンの再割り当て

イージー アクセス キーボードのアイコンは、Windowsデスクトップのステータスバーに表示されています。イージー アクセス ボタンの割り当てを変更する手順については、CPQEAIUI.hlpファイルを参照してください。

イージー アクセス ボタンのロックとアンロック

システム管理者は、イージー アクセス ボタンをロックおよびアンロックできます。ロックされた後の各ボタンは、.bcmファイルを変更することでのみ再割り当てができます。イージー アクセス ボタンの管理に必要な権限については、CPQEAIUI.hlpを参照してください。

イージー アクセス ボタンのアイコン シート

イージー アクセス ボタンのアイコン シートは、各ボタンの割り当てを視覚的に識別するために役立ちます。イージー アクセス ボタンの割り当てを変更した場合は、同時に、テンプレートを利用して変更したボタンの機能を表すアイコンを選択し、アイコン シートも変更しておくと便利です。Paper Insert Template.doc ファイルは、初期状態では C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support にインストールされています。



正しく位置が揃うように、アイコン周囲の余白を調整する必要がある場合があります。

Windowsロゴ キー

Windowsオペレーティング システム内では、Windows キーを他のキーと組み合わせてさまざまな機能を実行することができます。

[Windows] + [F1]	ヘルプ画面を表示します
[Windows] + [Tab]	タスクバーのボタンを切り替えます
[Windows] + [E]	エクスプローラの[マイ コンピュータ]を起動します
[Windows] + [F]	ファイルやフォルダの検索を起動します
[Windows] + [Ctrl] + [F]	ほかのコンピュータの検索を起動します
[Windows] + [M]	開いているすべてのアプリケーションを最小化します
[Shift] + [Windows] + [M]	最小化したすべてのアプリケーションを元に戻します
[Windows] + [R]	[「ファイル名を指定して実行」ダイアログ ボックス] を表示します

マウス

ほとんどのアプリケーションは、マウスをサポートしていますが、ボタンの機能は、アプリケーションによって異なります。

シリアル番号の記載位置

各コンピュータには固有のシリアル番号が付いています。このシリアル番号は、コンピュータのアクセスパネルの隅やリアパネルに記載されています。

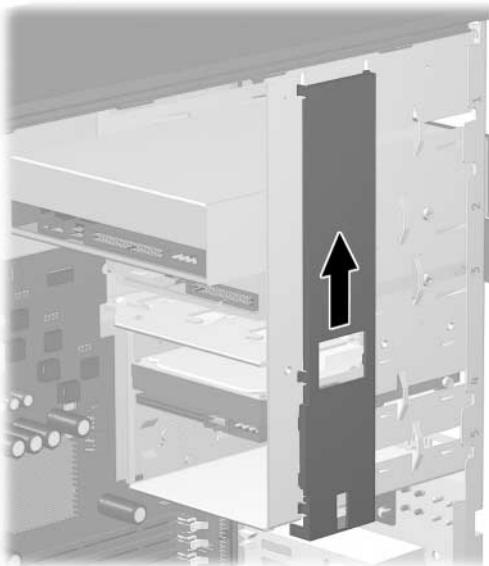
サポート窓口へのお問い合わせの際には、この番号をお手元に用意してください。

ミニタワー構成からデスクトップ構成への変更

以下の手順で、ミニタワー構成からデスクトップ構成に変更します。

1. このガイドの第2章の「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。
2. このガイドの第2章の「フロントパネルの取り外し」の手順に従って、フロントパネルを取り外します。
3. 5.25インチのドライブベイに装着されているドライブから、電源ケーブルや信号ケーブルをすべて抜き取ります。

4. 5.25インチのドライブベイからドライブを取り外すには、図のようにドライブロックをスライドさせます。ドライブのケーシングがつかめるようになるまでドライブを背面から慎重に押します。



ドライブロックを使用してドライブを解放する



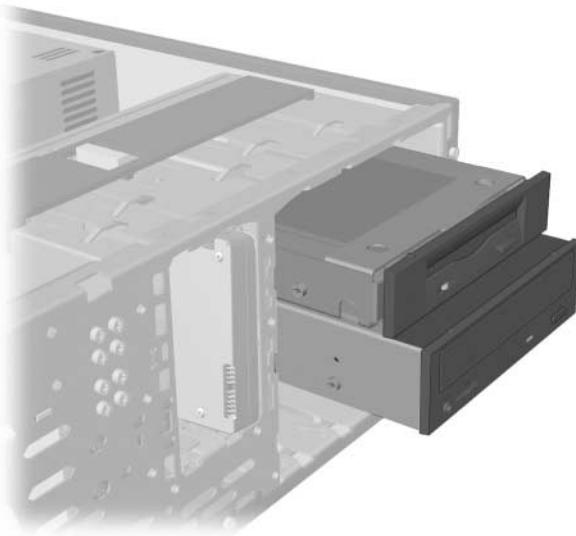
注意: ドライブを取り外すときに、ドライブのフェイスプレートを持たずに、ドライブのケーシングのみを持つようにしてください。

5. ドライブのケーシングを持ち、ドライブを慎重に引き出します。



注意: ドライブを取り外す際は、ドライブベイの前面から引っ張らないでください。ドライブのフロントパネルを破損しないように、ドライブおよびドライブのケーシングは、背面から押し出してからドライブベイの前面より取り出してください。

6. ワークステーションを横置きにして、ドライブベイにドライブを慎重に挿入します。



ドライブの取り付け



注意：ドライブを取り付ける際に強く力を加えすぎると、ドライブが破損することがあります。



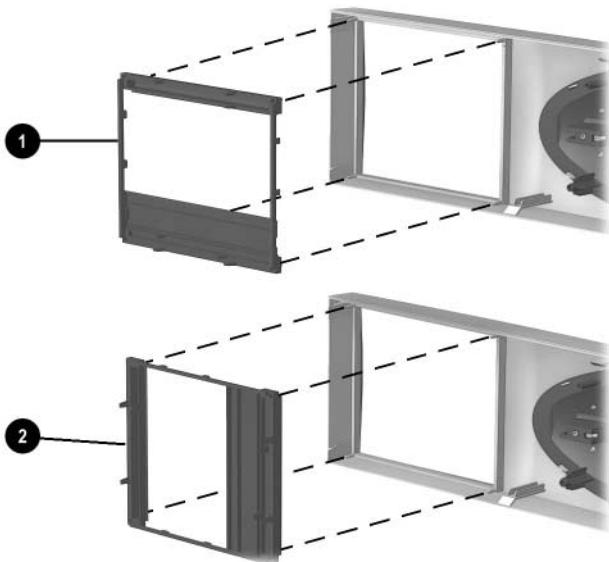
デスクトップ構成の場合、ディスクケットドライブは、適切な間隔でシャーシに装着するため、最上段のベイ（ベイ3）に装着してください。すべてのドライブが正しく挿入されると、ドライブロックによって固定されます。

7. 各ドライブの電源ケーブルと信号ケーブルを元どおりに取り付けます。

8. 第2章の「ドライブベイカバーの取り外し」の手順に従ってサブパネル①を取り外し、ドライブベイカバーを付けたサブパネルを、デスクトップ構成にしたときに正しい向きになるように取り付けます②。



注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロントパネルから取り外してください。サブパネルを引き出すときに傾けてしまうと、サブパネルをフロントパネルに取り付けるためのピンが破損することがあります。



ミニタワー構成からデスクトップ構成へ変更する



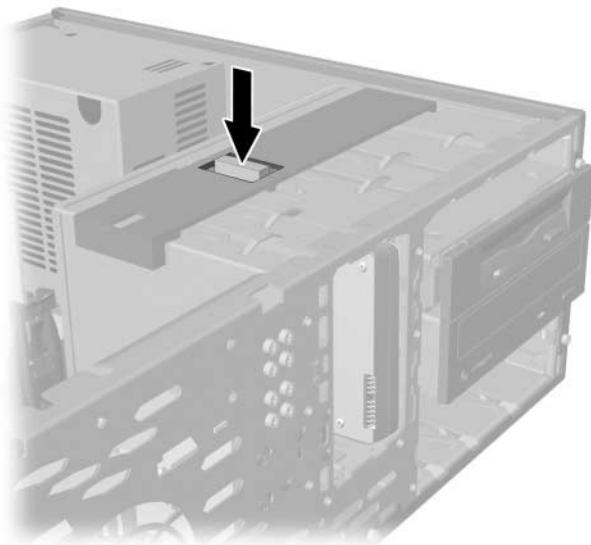
ミニタワー構成からデスクトップ構成に変更する場合は、ワークステーションに付属の交換用サブパネルを使用し、サブパネルを取り付けるときは、HPロゴが正しい向きになるようにしてください。

9. サブパネル、フロントパネル、およびワークステーションアクセスマップを取り付けます。サブパネルとフロントパネルがアライメントタブからはずれないように注意してください。
10. 電源コードをACコンセントに差し込みアースします。ネットワークコネクタとすべての外部装置のケーブルをシステムに接続します。

デスクトップ構成からミニタワー構成への変更

以下の手順で、デスクトップ構成からミニタワー構成に変更します。

1. このガイドの第2章の「ワークステーションのアクセス パネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセス パネルを取り外します。
2. このガイドの第2章の「フロント パネルの取り外し」の手順に従って、フロント パネルを取り外します。
3. 5.25インチのドライブ ベイに装着されているドライブから、電源ケーブルや信号ケーブルをすべて抜き取ります。
4. 5.25インチのドライブ ベイからドライブを取り外すには、図のようにドライブロック ボタンを押します。



ドライブロックを使用してドライブを解放する

5. ドライブロック ボタンを押しながら、ドライブのケーシングがつかめるようになるまでドライブを背面から慎重に押します。



注意: ドライブを取り外すときに、ドライブのフェイスプレートを持たずに、ドライブのケーシングのみを持つようにしてください。

6. ドライブのケーシングを持ち、ドライブを慎重に引き出します。



注意: ドライブを取り外す際は、ドライブベイの前面から引っ張らないでください。ドライブのフロントパネルを破損しないよう、ドライブおよびドライブのケーシングは、背面から押し出してから、ドライブベイの前面より取り出してください。

7. ワークステーションを縦置きにして、ドライブベイにドライブをゆっくりと挿入します。



ドライブの取り付け



注意: ドライブを取り付ける際に強く力を加えすぎると、ドライブが破損することがあります。



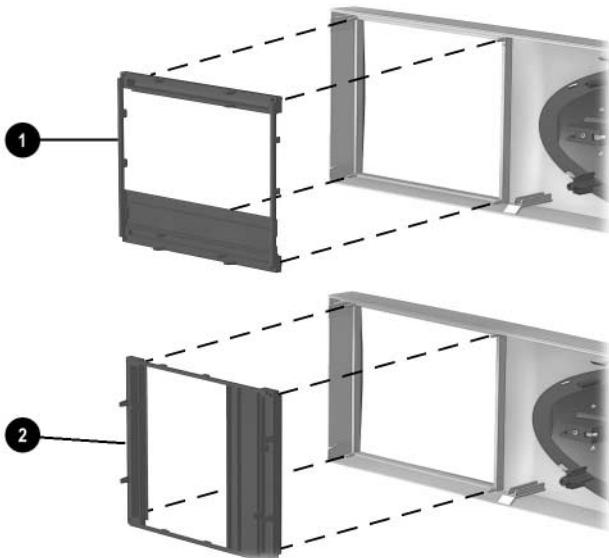
ミニタワー構成の場合、ディスクケットドライブは、適切な間隔でシャーシに装着するため、上から3番目のベイに装着してください。すべてのドライブが正しく挿入されると、ドライブロックによって固定されます。

8. 各ドライブの電源ケーブルと信号ケーブルを元どおりに接続します。

9. 第2章の「ドライブベイカバーの取り外し」の手順に従ってサブパネル①を取り外し、ドライブベイカバーを付けたサブパネルを、ミニタワー構成にしたときに正しい向きになるように取り付けます②。



注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロントパネルから取り外してください。サブパネルを引き出すときに傾けてしまうと、サブパネルをフロントパネルに取り付けるためのピンが破損することがあります。



デスクトップ構成からミニタワー構成へ変更する



デスクトップ構成からミニタワー構成に変更する場合は、ワークステーションに付属の交換用サブパネルを使用し、サブパネルを取り付けるときは、HPロゴが正しい向きになるようにしてください。

10. サブパネル、フロントパネル、ワークステーションのアクセスパネルを取り付けます。サブパネルとフロントパネルがアライメントタブから離れないように注意してください。
11. 電源コードをACコンセントに差し込みアースします。ネットワークコネクタとすべての外部装置のケーブルをシステムに接続します。

ハードウェアのアップグレード

この章では、ワークステーション アクセス パネルとフロント パネルを取り外す方法について説明します。また、次のハードウェア コンポーネントを取り付ける方法についても説明します。

- メモリ
- ドライブ
- 拡張ボード
- プロセッサ



ワークステーションにオプションのハードウェアや他社製のデバイスを取り付ける前に、プリインストール ソフトウェアのセットアップを完了させることをお勧めします。

取り付け手順の概要

どのオプションを取り付ける際にも、この手順どおりに行うようにしてください。



警告 :火傷の危険がありますので、本体内部の温度が下がっていることを確認してから作業してください。



警告 :感電や火災が発生したり、装置を損傷する場合がありますので、電話回線のモジュラージャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。



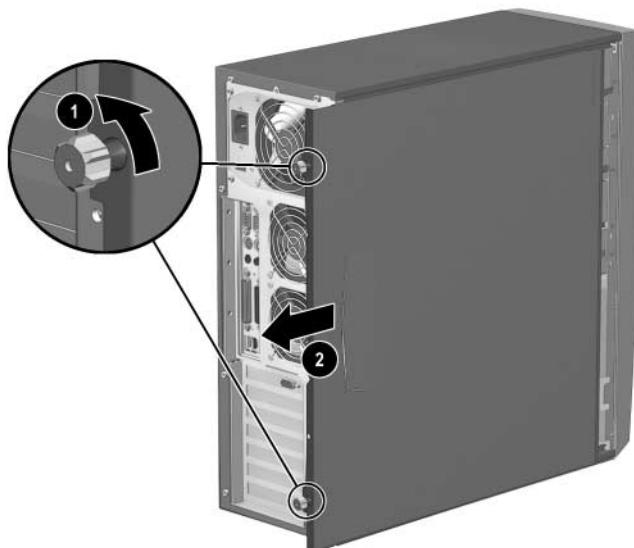
注意：静電気の放電により、ワークステーションやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまつた静電気を放電してください。

1. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンし、ワークステーション本体と外部装置の電源を切ります。ACコンセントから電源コードを抜き取ります。
2. ワークステーションに接続されているキーボード、モニタ、マウス、ネットワークケーブルやその他の装置をすべて取り外します。
3. ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。詳しくは、この章の「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」を参照してください。
4. ドライブを取り付けたり取り外したりする場合は、この章の「フロントパネルの取り外し」を参照してください。
5. メモリ、ドライブ、拡張ボード、プロセッサ、バッテリなどのオプション製品を取り付けます。取り付け作業について詳しくは、この章の該当する項または付録を参照してください。また、オプション製品に付属のマニュアルを参照してください。
6. ワークステーションのアクセスパネルと、取り外している場合はフロントパネルを元のとおりに取り付けます。
7. キーボード、マウス、モニタ、ネットワークケーブルやその他の外部装置をすべて元のとおりに接続します。
8. ACコンセントに電源コードを差し込みます。
9. 必要に応じてワークステーションの再設定を行います。
10. 必要に応じて[コンピュータの動作チェック (TEST)]ユーティリティを実行して、ワークステーションの動作チェックを行います。

ワークステーションのアクセス パネルの取り外し

以下の手順で、ワークステーションのアクセス パネルを取り外します。

1. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、ワークステーション本体と外部装置の電源を切ります。
2. ACコンセントから電源コードを抜き取ります。
3. 次の図のように、2つのネジを緩めます①。
4. アクセス パネルを背面に向けてスライドさせます②。



2つのネジを緩めてワークステーションのアクセス パネルを取り外す

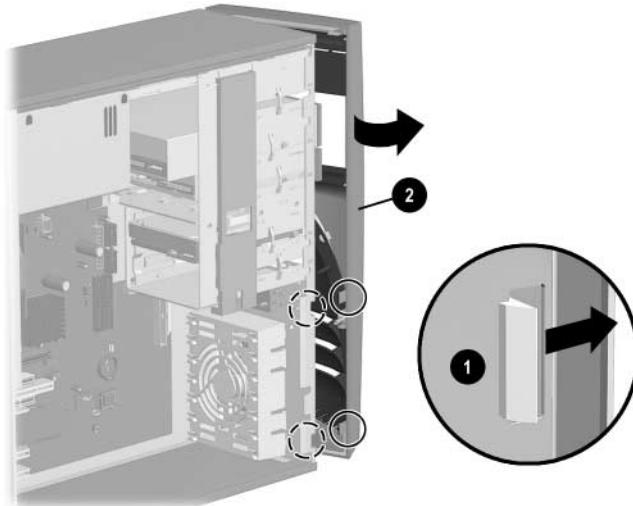


ワークステーションのアクセス パネルを元に戻すときは2つのネジを完全に締めてください。

フロントパネルの取り外し

以下の手順で、ワークステーションのフロントパネルを取り外します。

1. 「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。
2. 次のようにして、フロントパネルを取り外します。
 - a. 2つのリリースラッチを押します①。
 - b. フロントパネルを回して、シャーシから取り外します②。



リリースラッチを押してフロントパネルを取り外す



フロントパネルを元のとおりにシャーシに取り付けるときは、必ず最初にヒンジを正しい位置に合わせてから取り付けるようにしてください。

システムメモリの増設

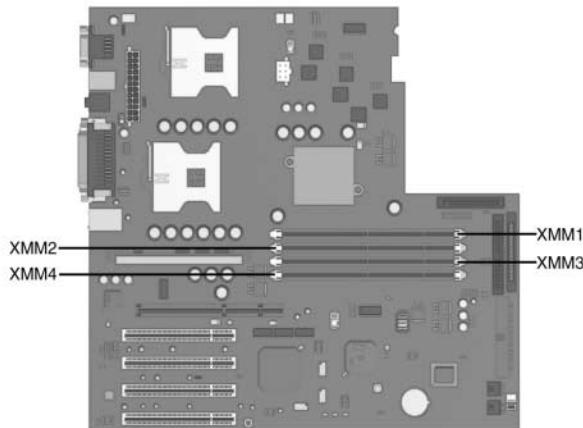
お使いのワークステーションは、ダブルデータ レート シンクロナス DRAM (DDR-SDRAM) デュアルインライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準のDIMMを取り付けすることができます。これらのソケットには、2つのメモリ モジュールが標準装備されています。最大容量のメモリ構成にするには、この標準装備のDIMMをより大きな容量のDIMMと交換しなければならない場合があります。また、空いている2つのメモリ ソケットに追加のDIMMを取り付けることもできます。

DIMMソケットの位置

お使いのワークステーションは、2つのチャネルで4基のDIMMソケット (1つのチャネルにつき2基のソケット) をサポートします。デュアルチャネルが機能するには、同じペアのDIMMを取り付ける必要があります。

4基のDIMMソケットは、XMM1とXMM3 (チャネルA)、およびXMM2とXMM4 (チャネルB) の番号が付けられています。それぞれのソケットのシステム ボード上の位置については、次の図を参照してください。



DIMMソケットの位置

DIMMの取り付け



警告：火傷の危険がありますので、本体内部の温度が下がっていることを確認してから作業してください。



注意：モジュールの破損を防止するため、メモリ モジュールを取り扱う際は、金属製の接点には触れないでください。



注意：静電気の放電により、ワークステーションやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまつた静電気を放電してください。詳しくは、「付録E 静電気対策」を参照してください。

DIMMを取り付ける場合は、必ず以下のガイドラインを守ってください。

- メモリ モジュールを増設する場合は、同じ種類の2つのDIMMを空いているメモリ ソケットに取り付ける必要があります。
- お使いのシステムでDDR-SDRAM DIMMがサポートされている場合、システムを正常に動作させるためには、必ず業界標準の184ピン、Registered ECC PC 2100 266MHzに準拠した、2.5ボルト DDR-SDRAM DIMMを使用してください。DDR-SDRAM DIMMは、CAS レイテンシが2または2.5(CL=2またはCL=2.5) の動作をサポートしている必要があります。さらに、JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) のSPD (Serial Presence Detect) 情報も含まれている必要があります。
- DIMMは、必ず正しい向きで取り付けてください。DIMMにあるキー スロットをDIMMソケットのタブに合わせ、DIMMをDIMMソケットに押し込みます。完全に挿入して正しく固定し、固定用アームを所定の位置にロックします。
- DIMMは、両方のメモリ チャネル間でペアになるように取り付けてください。チャネルAの各DIMMソケットには、必ずチャネルBのDIMMソケットに取り付けたDIMMと同じものを取り付けてください。正しいコンフィギュレーションの例については、この章の「DIMM取り付けのコンフィギュレーション」を参照してください。

- HPがテストし、承認済みのDIMMのみを使用してください。品質と信頼性の面で、すべてのDIMMがHPの基準を満たしているわけではありません。



注意：上記のガイドラインに従ってDIMMを取り付けないと、お使いのワークステーションは正常に動作しません。

DIMM取り付けのコンフィギュレーション

DIMMは、次の表に示すコンフィギュレーションに従って取り付けてください。

DIMM取り付けのコンフィギュレーション

可能なコンフィギュレーション	メモリ チャネルA		メモリ チャネルB	
	DIMMソケット	DIMMソケット	DIMMソケット	DIMMソケット
	XMM1	XMM3	XMM2	XMM4
1	DIMM		DIMM	
2		DIMM		DIMM
3	DIMM	DIMM	DIMM	DIMM

モジュールを4つ取り付ける場合、デュアルチャネルの動作に必要な同じペアとは、XMM1とXMM2に同じ種類のDIMMを取り付け、XMM3とXMM4に同じ種類のDIMMを取り付ける必要があるということです。

モジュールを2つだけ取り付ける場合は、同じものでなければならず、XMM1とXMM2、またはXMM3とXMM4のどちらかに取り付ける必要があります。デュアルチャネルが機能するには、各チャネルに1つのDIMMが取り付けられている必要があります。

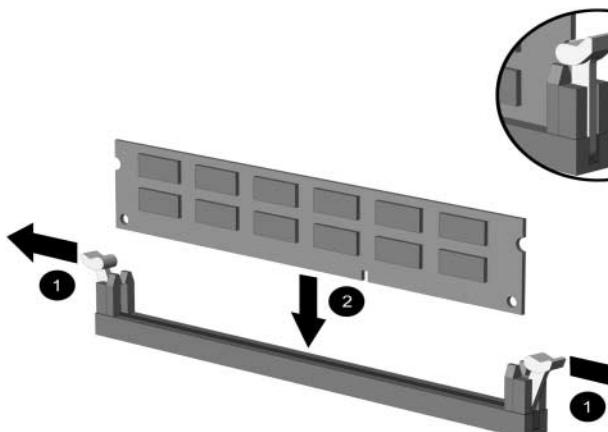
DIMMの取り付け

以下の手順に従ってDIMMを取り付けます。

1. 「ワークステーションのアクセス パネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセス パネルを取り外します。
2. 以下の図に従ってDIMMモジュールを取り付けます。



注意：コンフィギュレーションのガイドラインを守らないと、システムが正常に動作しません。



DIMMの取り付け

3. ワークステーションを元のとおりに組み立てます。

DIMMの取り外し

メモリ モジュールをDIMMソケットから取り外すには、「DIMMの取り付け」の項の手順を逆の順序で実行します。

ドライブの増設

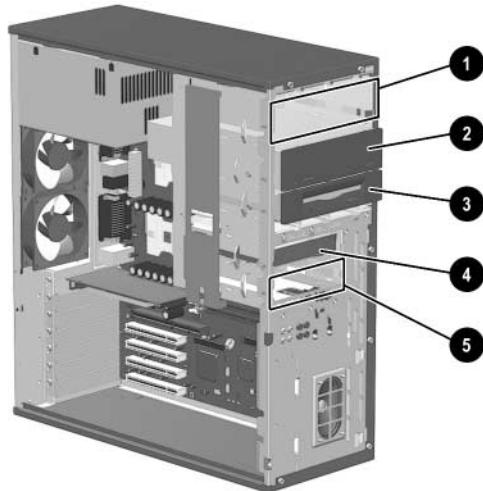
ここでは、ドライブベイのコンポーネントについて説明します。ドライブベイカバーの取り外し、およびドライブの取り付けまたは取り外しの手順についても説明します。

ドライブベイのコンポーネント

お使いのワークステーションには、次のような構成で最高5台のドライブを内蔵できます。ドライブベイ1から3は、ワークステーションの前面にあります。ドライブベイ4と5は、ワークステーションの内側にあります。お使いのシステムは、さまざまなドライブコンフィギュレーションをサポートします。

ミニタワーのドライブ ベイの位置

 ドライブ ベイ番号は、フロントパネルの後のシャーシに示されています。

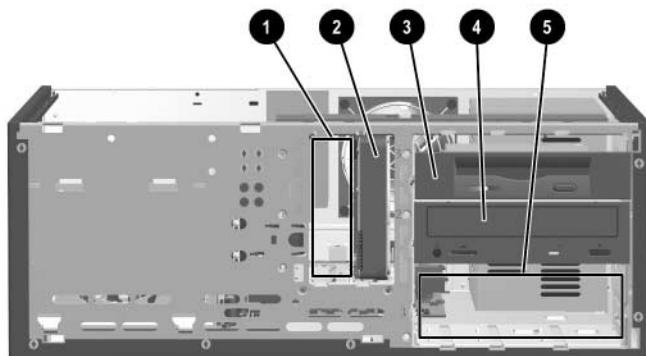


ミニタワー構成でのドライブ ベイの位置

ドライブ ベイのコンポーネント

ベイ	ドライブ コンポーネント
①	5.25インチ、1/2ハイトオプションのリムーバブルメディア用ベイ
②	5.25インチ、1/2ハイトオプションのリムーバブルメディア用ベイ (オプティカル ドライブ用)
③	5.25インチ、1/3ハイトリムーバブルメディア用ベイ (3.5インチ、ディスクケット ドライブ用)
④	3.5インチ、1/3ハイト ハードディスク ドライブ用ベイ
⑤	3.5インチ、1/3ハイト ハードディスク ドライブ用ベイ

デスクトップ構成でのドライブ ベイの位置



デスクトップ構成でのドライブ ベイの位置

ドライブ ベイのコンポーネント

番号	ベイ	ドライブ コンポーネント
①	5	3.5インチ、1/3ハイト ハードディスク ドライブ用ベイ
②	4	3.5インチ、1/3ハイト ハードディスク ドライブ用ベイ
③	3	5.25インチ、1/3ハイト リムーバブル メディア用ベイ (3.5インチ、ディスクケット ドライブ用)
④	1	5.25インチ、1/2ハイト オプションのリムーバブル メディア用ベイ
⑤	2	5.25インチ、1/2ハイト オプションのリムーバブル メディア用ベイ

ドライブを取り付けるための準備

テープ ドライブ、CD-ROMまたはDVD-ROM ドライブ、ディスクケット ドライブなどのリムーバブル メディア ドライブを取り付けるには、ドライブ ベイ カバーを取り外します。

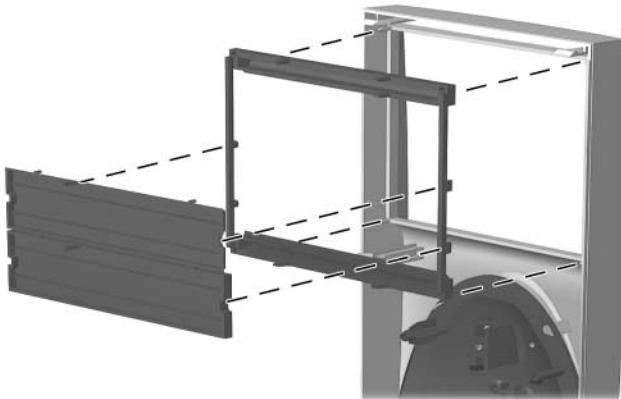
ドライブ ベイ カバーの取り外し

ドライブ ベイ カバーを取り外すには、以下の手順に従います。

1. この章の「ワークステーションのアクセス パネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセス パネルを取り外します。
2. この章の「フロント パネルの取り外し」の手順に従って、フロント パネルを取り外します。
3. フロント パネルから、ドライブ ベイ カバーが取り付けられているサブ パネルをそっと引いて取り外します。



注意: サブパネルは、まっすぐな状態を保ったままフロント パネルから取り外してください。サブパネルを引き出すときに傾けてしまうと、サブパネルをフロント パネルに取り付けるためのピンが破損することがあります。



サブパネルからのドライブ ベイ カバーの取り外し

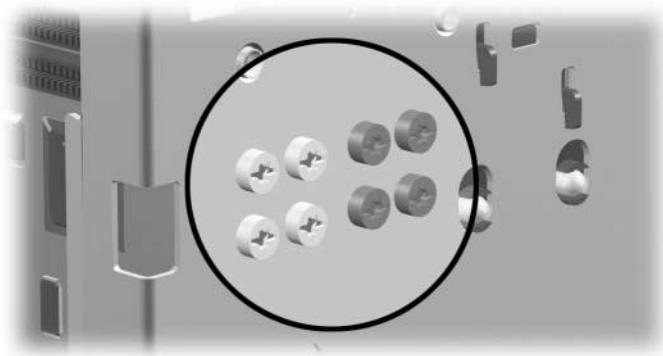


サブパネルを取り付けるときは、必ずピンの位置や残りのドライブ ベイ カバーが正しい向きになるようにしてください。

ミニタワー構成からデスクトップ構成に変更する場合は、ワークステーションに付属の交換用サブパネルを使用し、サブパネルを取り付けるときは、HP ロゴが正しい向きになるようにしてください。

ドライブ取り付け用ネジの位置

お使いのワークステーションには、予備のガイド用ネジがフロント パネルの裏に付属しています。ドライブを取り付ける際、ドライブを正しい位置で支えるためにこれらのネジを使用します。オプションのドライブによっては、メートル式のネジ（ミリネジ）を使用するものがあります。その場合は、黒いネジを使用してください。



ガイド用ネジの位置

ハードディスク ドライブの取り付け

以下の各項で、ハードディスク ドライブを3.5インチのドライブ ベイおよび5.25インチのドライブ ベイに取り付ける手順を説明します。

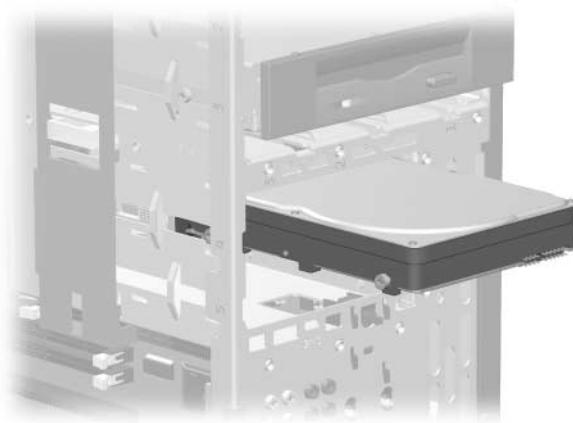
ハードディスク ドライブの3.5インチ ドライブ ベイへの取り付け



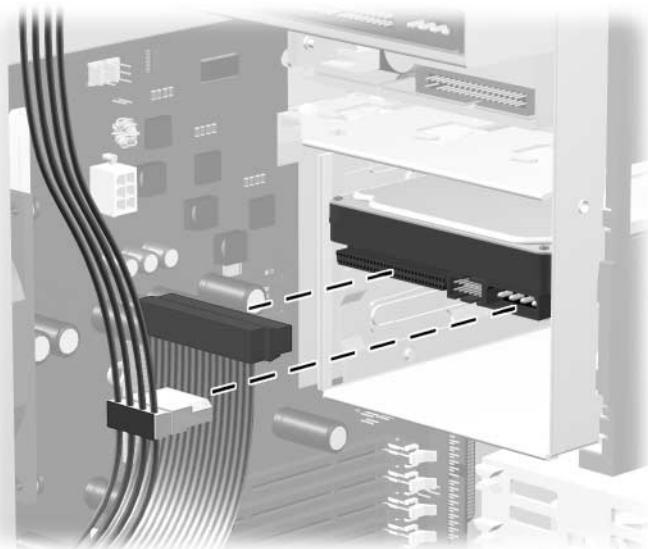
SCSIデバイスを取り付ける場合は、付録Bの「SCSIデバイス」を事前にお読みください。

ハードディスク ドライブを3.5インチ ドライブに取り付けるには、以下の手順に従います。

1. この章の「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。
 2. この章の「フロントパネルの取り外し」の手順に従って、フロントパネルを取り外します。
- 次の2つの図に従って、ハードディスク ドライブを3.5インチ ドライブ ベイに取り付けます。



ハードディスク ドライブの3.5インチのハードディスク ドライブ ベイへの取り付け



信号ケーブルと電源ケーブルの接続

3. ケーブルの端を適切なシステムボードコネクタに接続します。適切なドライブコネクタの位置については、第1章の「システムボードの各部」を参照してください。
4. ワークステーションを元のとおりに組み立てます。

ハードディスクドライブの5.25インチドライブベイへの取り付け

3.5インチのハードディスクドライブを5.25インチの1/2ハイトドライブベイに取り付ける場合は、ドライブをアダプタ内に入れる必要があります。

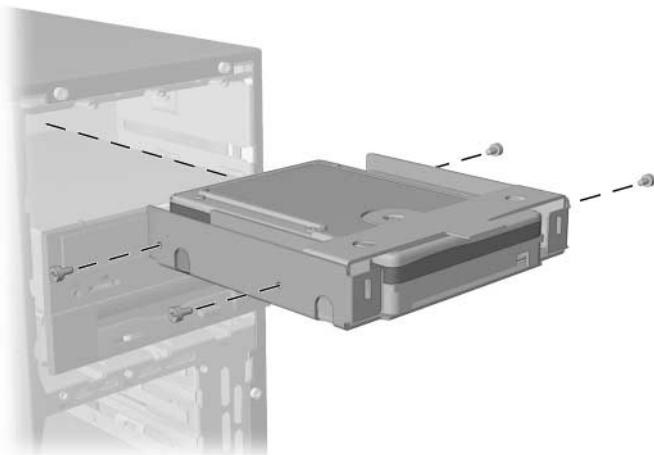


SCSIデバイスを取り付ける場合は、付録Bの「SCSIデバイス」を事前にお読みください。

ドライブとアダプタを取り付けるには、以下の手順に従います。

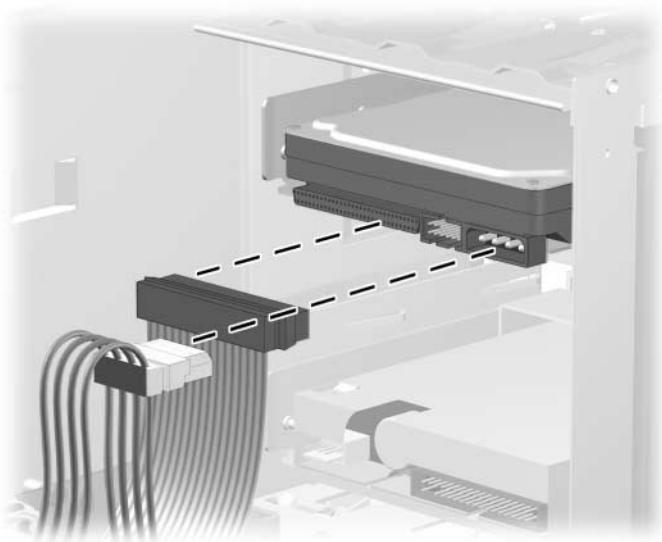
1. この章の「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。
2. この章の「フロントパネルの取り外し」の手順に従って、フロントパネルを取り外します。

3. フロントパネルの後ろから、ワークステーションのシャーシ上の4つのガイドネジを取り外します。取り外しの手順については、この章の「ドライブ取り付け用ネジの位置」を参照してください。
4. 次の図のように、4つのガイド用のネジをドライブに取り付けて、ハードディスクドライブアダプタにドライブを固定します。



ガイド用ネジの位置合わせと3.5インチ ドライブの取り付け

5. アダプタをドライブケージの前面に滑り込ませて、ドライブベイに取り付けます。ドライブロックが所定の位置に収まると、アダプタが自動的に固定されます。



信号ケーブルと電源ケーブルの接続

6. ケーブルの反対側の端を適切なシステム ボード コネクタに接続します。
適切なドライブ コネクタの位置は、第1章の「システム ボードの各部」
を参照してください。
7. ワークステーションを元のとおりに組み立てます。

ドライブの取り外し



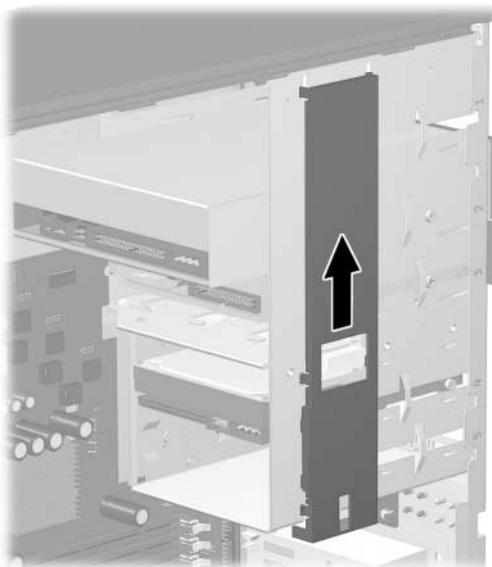
ワークステーションに搭載されているUltra ATA ハードディスク ドライブを
SCSI ハードディスク ドライブと交換する場合は、マルチモードのLVD SCSI
ケーブル オプション キットが必要です。

次の手順に従って、ドライブを取り外します。

1. この章の「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。

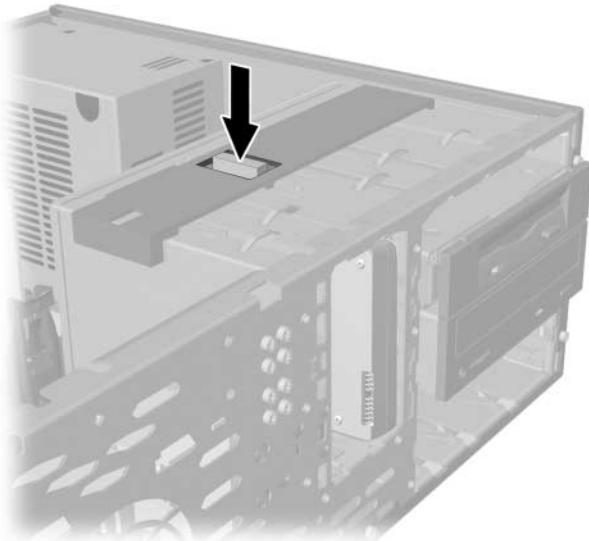
電源コードを接続したまま作業を行うとシステムが正常に動作しなくなる可能性があります。必ず電源コードをACコンセントから抜き取ってください。

2. この章の「フロントパネルの取り外し」の手順に従って、フロントパネルを取り外します。
3. ドライブの背面から電源ケーブルと信号ケーブルを抜き取ります。CD-ROMドライブの場合は、オーディオケーブルも抜き取ります。
4. ドライブロックを解放します。
 ミニタワー構成の場合は、ドライブロックをスライドさせて、ドライブベイ内のドライブのロックを外します。



ドライブロックからのドライブの解放

- デスクトップ構成の場合は、ドライブロック ボタンを押して、ドライブのロックを外します。



ドライブロック ボタンを使用したドライブの解放

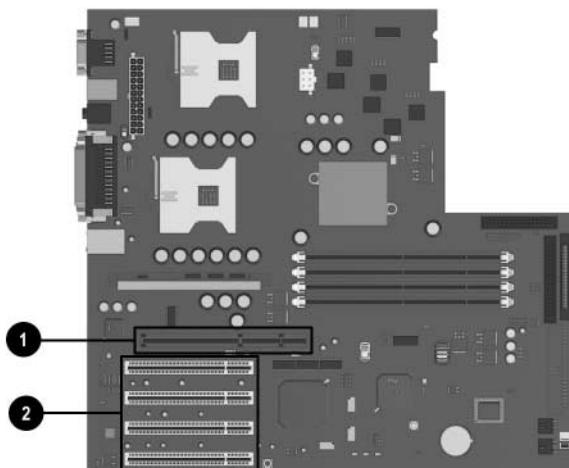
5. ドライブロックをスライドさせながら、ワークステーションの前面でドライブのケースがつかめるまでドライブを背面から押します。
6. ドライブのケースを持ち、ドライブ ベイからドライブを引き出します。
7. ドライブを帯電防止パッケージに入れて保管します。
8. ワークステーションを元のとおりに組み立てます。

拡張ボードの取り付けおよび取り外し

この項では、PCIおよびAGP拡張ボードの取り付けおよび取り外し方法について説明します。

AGPソケットおよびPCIソケットの位置

お使いのワークステーションには、1つのAGPソケットと4つの32ビット、33MHzのPCIソケットがあります。次の図に、各ソケットの位置を示します。



AGPソケットおよびPCIソケットの位置

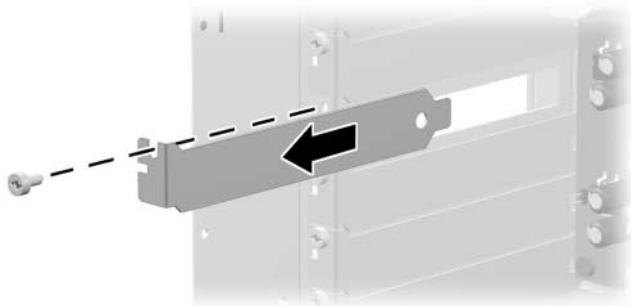
① AGPソケット × 1

② PCIソケット × 4

拡張ボードの取り付け

次の手順で、拡張ボードを取り付けます。

1. この章の「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。
2. 取り付けるボードの種類に応じた、空いているAGPソケットまたはPCIソケットを確認します。
3. 拡張スロットカバーを固定しているネジを取り外し、図のようにスロットカバーを取り外します。

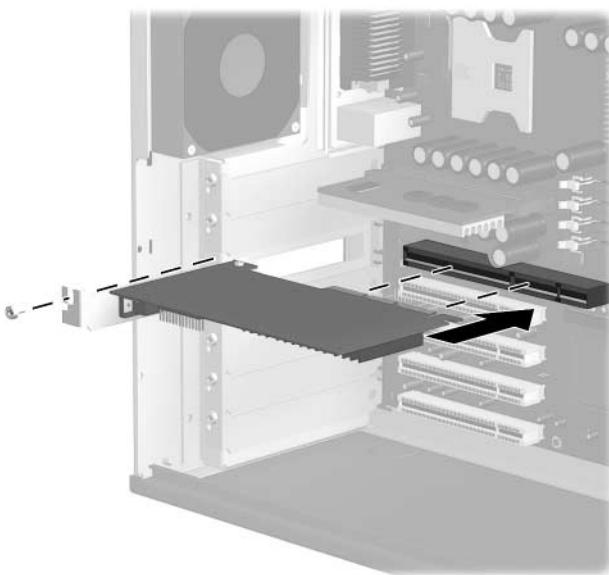


ネジと拡張スロットカバーの取り外し

4. 拡張ボードをソケットに差し込みます。ボードがソケットの奥にしっかりと固定されるまで差し込みます。



AGP拡張ボードを取り付ける場合は、ボードにATXブラケットが付いている必要があります。



拡張ボードの取り付け

5. ネジでボードをソケットに固定します。
6. ワークステーションを元のとおりに組み立てます。
7. 必要に応じてワークステーションの再設定を行います。

拡張ボードの取り外し

拡張ボードを取り外すには、「拡張ボードの取り付け」の項の手順を逆の順序で実行します。その際、以下の点に注意してください。

- 拡張ボードは、必ず帯電防止パッケージに入れて保管してください。
- 拡張スロットカバーを開口部にはめ、ネジで固定してください。

プロセッサの増設

お使いのワークステーションは、マルチ プロセッサ システムにアップグレードできます。セカンダリ プロセッサは、同じスピード、同じキャッシュ サイズ、同じ種類のプロセッサでなければなりません。



警告 :火傷の危険がありますので、本体内部の温度が下がっていることを確認してから以下の手順を行ってください。



注意 :静電気の放電により、ワークステーションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまつた静電気を放電してください。

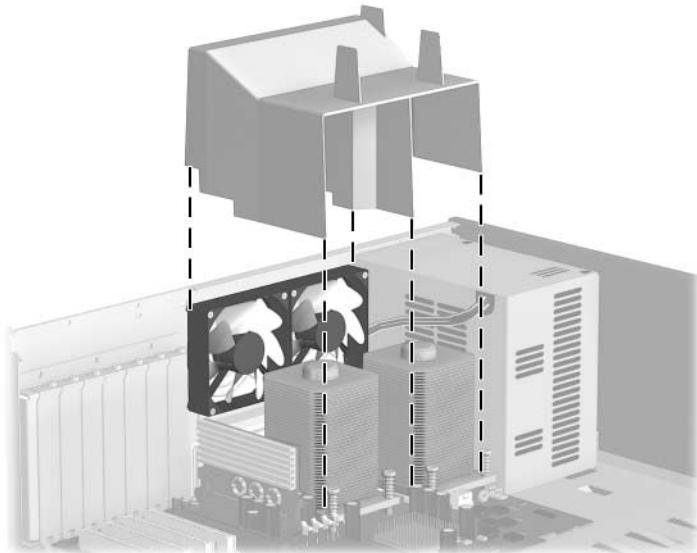


注意 :誤った方法でプロセッサを取り付けた場合、システム ボードを損傷するおそれがあります。プロセッサの取り付けは、HP 正規保守代理店または HP 製品販売店に依頼してください。ご自身で取り付ける場合は、作業を始める前にすべての手順を注意深くお読みになってから行ってください。

セカンダリ プロセッサを取り付ける前に、エア バッフルを取り外す必要があります。

次の手順で、エア バッフルを取り外します。

1. この章の「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。
2. ワークステーションをデスクトップ構成の向きに置きます。
3. エア バッフルを取り外します。
 - a. エア バッフルとファンアセンブリとの間に隙間ができるまで、エア バッフルを慎重に持ち上げます。
 - b. エア バッフルをシャーシの外側に出します。



エア バッフルの取り外し

4. セカンダリ プロセッサを取り付けます(次のページの図を参照してください)。
 - a. セカンダリ プロセッサのソケット レバー①を完全に開きます(レバーを完全に開ききったときの角度は、約135度です)。



注意: プロセッサのピンは繊細で、簡単に曲がります。プロセッサをソケットに差し込む際には、最大限の注意を払ってください。

- b. プロセッサ②のピンの2つの切り込みを、プロセッサ ソケットの端の2つの切り込みと合わせ、プロセッサを取り付けます。プロセッサの下面が、プロセッサ ソケットの上面と同じ高さになるようにします。



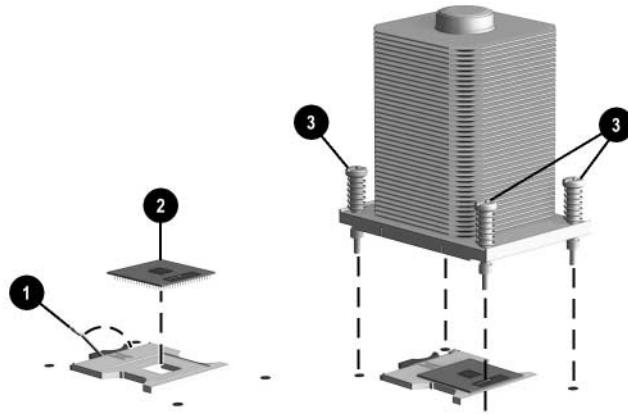
注意: プロセッサを交換する目的でプロセッサを1つだけ取り付ける場合は、プロセッサをプライマリ プロセッサ ソケットに取り付けないと、ワーカステーションが機能しません。

- c. ソケット レバーを閉じながら、プロセッサの上面を軽く押し下げます。
- d. プロセッサがソケットに適切に収まっていることを確認します。プロセッサが正常に取り付けられていれば、指でプロセッサをソケットから軽く持ち上げようとしても持ち上がりません。
- e. プロセッサの上にヒートシンクをセットする前に、ヒートシンクの底にサーマルグリースを配置します。



お使いのワーカステーションには、新しいヒートシンクを取り付けるセカンダリ プロセッサの周辺にネジがあらかじめ取り付けられている場合があります。これらのネジを取り外してから新しいヒートシンクを取り付けてください。

- f. システム ボード上の穴に固定ネジを合わせます。
- g. バネが完全に圧縮された状態になるまで、ネジを完全に締めます③。

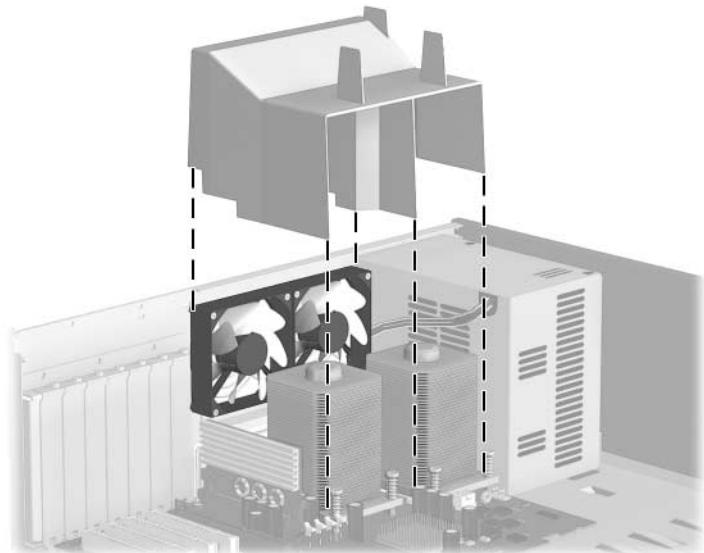


セカンダリ プロセッサ/ヒートシンク アセンブリの取り付け

5. エア バッフルを取り付けます。
 - a. エア バッフルをヒートシンクの上のシャーシの中に慎重に降ろします。
 - b. ファンアセンブリに収まるまで、エア バッフルを慎重に押し下げます。



注意：プロセッサを適切に冷却するために、エア バッフルは必須の部品です。エア バッフルが取り付けられていないと、プロセッサは過熱しないように稼働速度を落とします。



エア バッフルを元どおりに取り付ける

6. ワークステーションを元どおりに組み立て、電源コードをACコンセントに差し込みます。

ワークステーションのアクセス パネルを元に戻すときは、2つのネジを完全に締めてください。ワークステーションのアクセス パネルが閉じられると、エア バッフルは所定の位置に収まります。



システムでソフトウェアの設定手順を完了させた後にセカンダリ プロセッサを取り付ける場合は、ハードウェア アブストラクション レイヤ (HAL) を手動でアップグレードする必要があります。セカンダリ プロセッサが設定前に取り付けられた場合は、手動によるアップグレードは不要です。コンポーネントを増設する前に、ソフトウェアの設定手順が完了していることをお勧めします。マルチプロセッサ HALへのアップグレードについては、プロセッサ アップグレード キットに付属のマニュアルを参照してください。

プロセッサのアップグレード

お使いのワークステーションは、既存のプロセッサをより高速のプロセッサと交換してアップグレードできます。既存のプロセッサを交換する前に、必要なハードウェア オプション キットをご購入ください。以下の項で説明するガイドラインと手順に従って、プロセッサをアップグレードしてください。

プロセッサをアップグレードする際の準備



警告 : 火傷の危険がありますので、本体内部の温度が下がっていることを確認してから作業してください。



注意 : 誤った方法でプロセッサを取り付けた場合、システム ボードを損傷する恐れがあります。プロセッサの取り付けは、HP 正規保守代理店または HP 製品販売店に依頼してください。ご自身で取り付ける場合は、作業を始める前にすべての手順を注意深くお読みになってから行ってください。



注意 : 静電気の放電により、ワークステーションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまつた静電気を放電してください。

必要なハードウェア コンポーネント

プロセッサをアップグレードする際には、HP製品販売店に連絡して、必要なハードウェア オプション キットをご購入ください。このキットには、次のものが含まれています。

- プロセッサ
- アルコールを含んだ綿パッド
- サーマル グリース付きヒートシンク

ヒートシンク/プロセッサ アセンブリを分離する際のガイドライン

お使いのワークステーションを新しいプロセッサでアップグレードする前に、既存のヒートシンクとプロセッサを取り外すために以下の作業を順番に実行する必要があります。

1. ヒートシンクとプロセッサは、お互いを固定している接着状態を剥がすために、最適な温度まで暖める必要があります。以下の項を参照してください。
 - ヒートシンクの冷却時間
 - ヒートシンクの加熱時間
2. ヒートシンクをプロセッサから分離します。
3. プロセッサをプロセッサ ソケットから取り出します。

ヒートシンクの冷却時間

プロセッサのチップから発生した熱でヒートシンクが熱くなると、手で持つことができなくなります。ヒートシンクを手に持って熱くなく、しかもヒートシンクをプロセッサに固定している接着状態が固くなりすぎない温度までヒートシンクを冷やすには、電源を切ってから約5分かかります。

ヒートシンクの加熱時間

冷えたプロセッサとヒートシンクの接着状態を剥がすために十分な熱を発生させるには、最小限のウォームアップ時間が必要です。



注意：ヒートシンクを無理に引き上げようすると、装置を損傷するおそれがあります。ヒートシンクをプロセッサに固定している部分が暖められて十分に柔らかくなつてから、ヒートシンクを取り外してください。

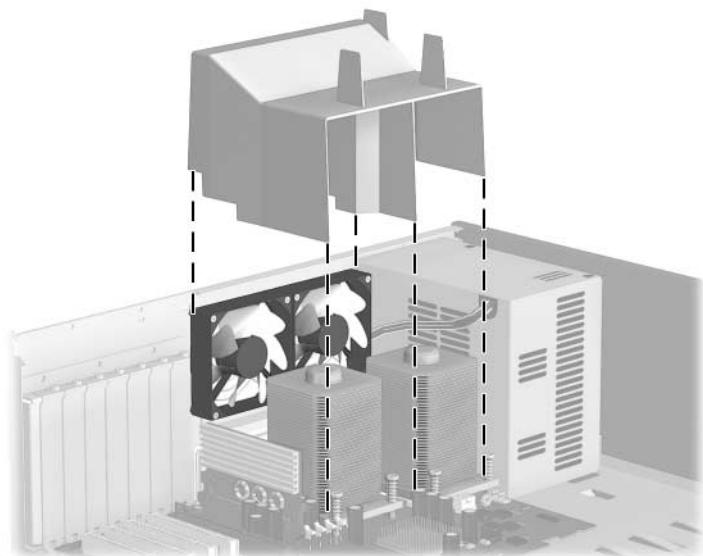
ヒートシンクを手で持つても熱すぎず、しかもヒートシンクをプロセッサに固定している部分が柔らかくなるように、以下の手順で電源をオン/オフしてヒートシンクを暖めてください（ただし、熱し過ぎないようにします）。

1. ワークステーションの電源を入れ、オペレーティングシステムを起動します。
2. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンし、ワークステーションと外部装置の電源を切ります。ACコンセントから電源コードを抜き取ります。

既存のプロセッサの取り外し

以下の手順で、既存のプロセッサを取り外します。

1. この章の「ワークステーションのアクセスパネルの取り外し」の手順に従って、ワークステーションのアクセスパネルを取り外します。
2. ワークステーションをデスクトップ構成の向きに置きます。
3. エアバッフルを取り外します。
 - a. エアバッフルとファンアセンブリとの間に隙間ができるまで、エアバッフルを慎重に持ち上げます。
 - b. エアバッフルをシャーシの外側に出します。



エアバッフルの取り外し

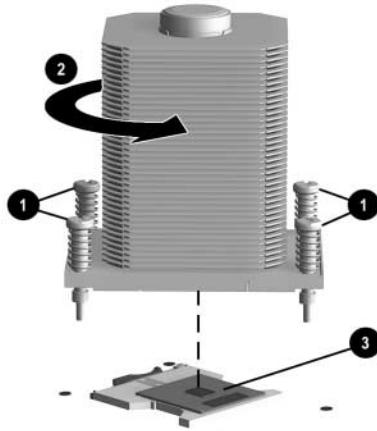
4. ヒートシンクに触れられるくらい暖まっていることを確認します。



注意：ヒートシンクを無理に引き上げようすると、装置を損傷するおそれがあります。ヒートシンクをプロセッサに固定している接着剤が暖められて十分に柔らかくなつてから、ヒートシンクを取り外してください。

触れたときにヒートシンクが冷たい場合は、この章の「ヒートシンク/プロセッサアセンブリを分離する際のガイドライン」を参照してください。

5. ヒートシンクを取り外します。
 - a. 固定ネジを緩めます①。
 - b. ヒートシンクを軽くひねり②、ヒートシンクをプロセッサに固定している接着剤を剥がします。
 - c. ヒートシンクをプロセッサから離して持ち上げます③。



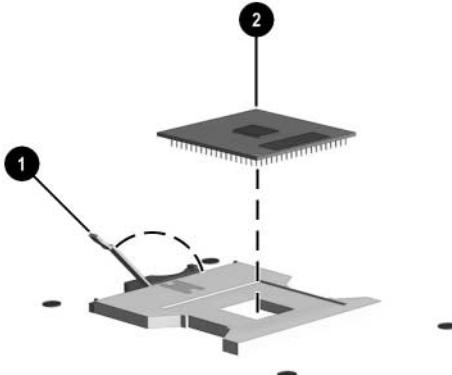
ヒートシンクをひねってプロセッサから外す



注意：ヒートシンクを無理に引き上げようすると、装置を損傷するおそれがあります。ヒートシンクをプロセッサに固定している接着剤が暖められて十分に柔らかくなつてから、ヒートシンクを取り外してください。

ヒートシンクが冷たい場合は、この章の「ヒートシンク/プロセッサを分離する際のガイドライン」を参照してください。

6. プロセッサを取り外します。
 - a. セカンダリ プロセッサのソケット レバー①を完全に開きます（レバーを完全に開ききったときの角度は、約135度です）。
 - b. プロセッサをプロセッサ ソケットから取り出します②。



プロセッサの取り外し

新しいプロセッサの取り付け

新しいプロセッサの取り付け手順については、この章の「プロセッサの増設」を参照してください。

A

仕様

hpワークステーションxw6000

寸法（ミニタワー構成時）		
高さ	44.8 cm	
幅	16.8 cm	
奥行き	45.1 cm	
寸法（デスクトップ構成時）		
高さ	16.8 cm	
幅	44.8 cm	
奥行き	43.7 cm	
重量（概算）	14.54 kg	
電源	115 VAC	230 VAC
動作電圧	90~132 VAC	180~264 VAC
定格電圧範囲	100~127 VAC	200~250 VAC
周波数	50~60 Hz	50~60 Hz
温度範囲		
動作時	10~35°C	
非動作時	-15~60°C	
湿度条件（結露せず）		
動作時	20~80%	
非動作時	10~90%	
動作保証高度（非圧縮）		
動作時	3,048 m	
非動作時	9,144 m	
電源出力	460 W	460 W
定格入力電源（最大）	8.6 A	4.3 A
放熱効率（最大）	2641 BTU/時	665 kg-cal/時

ハードディスク ドライブの取り付け

Ultra ATAデバイスのケーブル セレクト機能

HP ワークステーション xw6000 の一部のモデルには、内蔵 Ultra ATA ハードディスク ドライブが標準装備されています。ドライブの構成には、このドライブをデバイス0（プライマリ ドライブ）またはデバイス1（セカンダリ ドライブ）として識別するケーブル セレクト機能を採用しています。

デバイス1は、ケーブルの中央コネクタに接続されたデバイスです。デバイス0は、ケーブルの端にあるコネクタに接続されたデバイスです（80芯ATAケーブルにのみ適用されます）。Ultra ATAケーブルの使用例については、この付録の「Ultra ATAデバイスの取り付けのガイドライン」を参照してください。

HPのハードディスク ドライブは、あらかじめジャンパがケーブル セレクト モードに設定されています。そのため、既存のドライブまたはオプションのドライブでは、ジャンパの設定を変更する必要はありません。他社製のハードディスク ドライブを購入した場合は、キットに付属のマニュアルを参照して、ケーブルの取り付け/設定を正しく行ってください。



プライマリ コントローラにセカンダリ ドライブを増設する場合は、ハードウェアの性能を活かすため、別売の80芯Ultra ATAケーブルを使用してください（モデルによってはこのケーブルが付属しています）。

Ultra ATAデバイスの取り付けのガイドライン

Ultra ATA ドライブを増設するときには、以下のガイドラインに従ってください。

- 複数のUltra ATAデバイスを取り付ける場合は、ハードウェアの性能を活かすために、プライマリUltra ATAチャネルとセカンダリUltra ATAチャネルにデバイスを分散させることをお勧めします。増設用Ultra ATAケーブルを使用して、増設デバイスをシステムボードに接続します。
- Ultra ATA-100ケーブルには次のような特徴があります。

最長18インチで、ドライブ0とドライブ1の間に最大6インチの間隔がとれる80芯のケーブル



UATA-100ケーブル

-
- ① デバイス0（プライマリ ドライブ）のコネクタ
 - ② デバイス1（セカンダリ ドライブ）のコネクタ
 - ③ システム ボード コネクタ
-

- ハードウェアの性能を活かすために、ハードディスク ドライブは、プライマリ コントローラに接続します。Ultra ATA CD-ROM ドライブ、テープ ドライブ、およびディスクケット ドライブなどの拡張デバイスは、セカンダリ コントローラに接続してください。
- 1/2ハイトベイには、1/3ハイトまたは1/2ハイトのどちらのドライブも取り付けることができます。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付けます。予備のガイド用ネジがワークステーションのシャーシの前面（フロントパネルの裏）に付属しています。オプション ドライブによっては、黒いメートル式ネジ（ミリネジ）を使用するものがあります。
- ケーブルにデバイスを1つだけ接続する場合は、終端（デバイス0）のコネクタにつなげる必要があります。

SCSIデバイス

この項では、SCSIデバイスのガイドラインおよび取り付けについて説明します。

SCSIデバイスのガイドライン

SCSIデバイスを取り付けて動作させる場合は、必ず以下のガイドラインに従ってください。

- 1枚のUltra SCSIコントローラで、チャネルごとに最大7台のSCSIデバイスをサポートできます。
- それぞれのWide-Ultra SCSI、Ultra-Wide SCSI、Wide Ultra2 SCSI、Ultra 320 SCSI、または160 SCSIコントローラで、チャネルごとに15台までのSCSIデバイスをサポートします。
- 複数のSCSIデバイスを取り付ける場合は、ハードウェアの性能を活かすために、利用できる場合は、チャネルAとチャネルBにデバイスを分散させることをお勧めします。
- 次のSCSIケーブルのご使用をお勧めします。
 - 最長53インチのツイストペア線、ターミネータ付きのLVDケーブル、各ドライブの間隔が最短5.25インチで最大5台のドライブが接続できるもの
- SCSIコントローラが正常に動作するには、取り付けられた各SCSIデバイスに固有のSCSI ID（0から7または8から15）が割り当てられる必要があります。SCSIコントローラは、デバイスが取り付けられている位置ではなくSCSI ID番号からSCSIデバイスを識別するので、SCSIデバイスをSCSIチェインのある位置から別の位置へ移しても、SCSIコントローラとSCSIデバイス間の通信には影響ありません。予約されているSCSI ID番号と利用できるSCSI ID番号は次のとおりです。
 - 0：プライマリ ハードディスク ドライブに予約されています。
 - 7：コントローラに予約されています。
 - 1から6と8から15：その他のSCSIデバイスで利用できます。
- IDE CD-ROMかIDE DVD-ROMのどちらかが、ベイ2に取り付けられて出荷されます。

- SCSI チェインは両端でターミネート（終端）してください。システム ボードによっては、SCSIケーブルの両端をシステム ボードに接続して ターミネート（終端）します。次のいずれかの方法でターミネート（終 端）できます。
 - ターミネータ内蔵ケーブルを使用する（このケーブルは、モデルに より付属しています）
 - 最後のコネクタにターミネート用の抵抗器を付けたケーブルを使用 する
 - ターミネート機能を有効にした SCSI デバイスを最後のコネクタに 接続する
 - ターミネート機能を有効にした外部SCSIデバイスを、コンピュータ のリア パネルにある外部SCSIコネクタに接続する
- ワークステーションの電源を入れる前にすべての外部 SCSI デバイスの 電源を入れてください。SCSI コントローラが外部デバイスを認識しま す。
- お使いのシステムでは、内蔵型のSCSIデバイスと、ハードディスク ドラ イブ、テープ ドライブ、CD-ROM ドライブなどの外付けSCSIデバイスを 組み合わせて使用できます。
- 同じ SCSI チェインまたは同じ SCSI チャネルでビット幅の異なる SCSI デ バイスを混在させることはお勧めできません。同じ チェインまたはチャ ネルでビット幅の異なるデバイスを混在させると、その チェイン内の データ転送速度は、最も遅いデバイスのデータ転送速度になります。同 一チャネルに Wide-Ultra2、Ultra 160、および Ultra 320 デバイスを混在さ せることはできますが、Narrowデバイス以外のデバイスと Narrowデバイ スは同一チャネルに混在させないでください。

オプションのSCSIデバイスについて詳しくは、デバイスに付属のマニュアル を参照してください。



注意: 電源装置への通気が妨げられ、過熱状態になることを防ぐために、ケーブルは、電源装置の通気孔付近に配線しないでください。

SCSIデバイスの取り付けのガイドライン



同じシステムにUltra ATAハードディスク ドライブとSCSIハードディスク ドライブを混在させると、Ultra ATA ドライブが起動ドライブになります。起動順序を変更するには、セットアップ ユーティリティで[F10]キーを押してください。

ハードディスク ドライブを交換する場合は、必ず交換用ドライブに、取り外すドライブと同じ種類のドライブを使用してください。Ultra ATAハードディスク ドライブをSCSIハードディスク ドライブと交換する場合は、マルチモードのLVD SCSIケーブル オプション キットが必要です。

SCSIハードディスク ドライブを1台だけ使用する場合は、ベイ4に取り付ける必要があります。

SCSIデバイスを取り付ける前に、以下の手順を実行してください。

- ドライブのSCSI IDを確認し、必要に応じて、SCSI IDを固有の番号に設定します。この付録の「SCSIデバイスのガイドライン」、またはデバイスに付属のマニュアルを参照してください。
- デバイスのターミネート機能を有効にするか無効にするかを確認します。必要に応じてターミネート機能を設定します。この付録の「SCSI ケーブルの使用」、またはデバイスに付属のマニュアルを参照してください。

SCSIコントローラ

お使いのワークステーションには、システム ボード上に内部コネクタ付きの、内蔵型単一チャネルUltra 160 SCSIコントローラが付属しています。

SCSIケーブルの使用

HPワークステーションxw6000には、モデルによって、LVD（低電圧ディファレンシャル）またはシングル エンドデバイスをサポートするマルチ モード SCSIケーブルが付属しています。このケーブルは、正面のドライブ ベイエリアの最大2台のSCSIデバイスをサポートします（UATAモデルにはSCSIケーブルが付属していません）。



ターミネータ プラグ付き5デバイス用SCSIケーブル



お使いのワークステーションに付属のケーブルは、図のケーブル（5デバイス用ケーブル）と異なる場合があります。



Narrow SCSIデバイスを取り付ける場合、68ピン-50ピン SCSIアダプタが必要です。

オプションの SCSIデバイスの取り付けについて詳しくは、デバイスのオプション キットに付属のマニュアルを参照してください。

SCSIデバイスと[SCSISelect]の使用

SCSIホストアダプタには、このホストアダプタを設定したり、SCSIディスクユーティリティを実行したりするための[SCSISelect]ユーティリティが搭載されています。次の手順で、[SCSISelect]ユーティリティを実行します。

- POST (Power-On Self Test) メッセージを有効に設定：POST中に "Press <Ctrl><A> for SCSISelect Utility" というメッセージが表示されたら、[Ctrl]+[A]キーを押します。
- POSTメッセージを無効に設定：HPのロゴ画面が表示されたら、任意のキーを押してこの画面を終了します。画面が終了したらすぐに[Ctrl]+[A]キーを押して、[SCSISelect]ユーティリティを実行します。

次のオプションがあるメニューが表示されます。

- Configure/View Host Adapter Settings (ホストアダプタの設定値のコンフィギュレーション/表示)
 - SCSI Bus Interface Definition (SCSIバスインターフェース定義)
 - ◆ Host Adapter SCSI ID (ホストアダプタのSCSI ID)
 - ◆ SCSI Parity Checking (SCSIパリティチェック)
 - ◆ Host Adapter SCSI Termination (ホストアダプタのSCSIターミネート)
 - Additional Options (その他のオプション)
 - ◆ Boot Device Options (ブートデバイスオプション)
 - ◆ SCSI Device Configuration (SCSIデバイスコンフィギュレーション)
 - ◆ Advanced Configuration Options (拡張コンフィギュレーションオプション)
- SCSI Disk Utilities (ディスクユーティリティ)
 - すべてのSCSIデバイスとSCSI ID番号の一覧



コンピュータ起動時のPOSTメッセージの有効(Enable)/無効(Disable)の設定に関しては、Documentation Library CDに収録されている『コンピュータセットアップ(F10)ユーティリティガイド』を参照してください。

バッテリの交換

バッテリの交換

ワークステーションに付属のバッテリは、リアルタイムクロックに電源を供給するためのもので、約3~5年間使用できます。バッテリを交換するときは、同等の3Vのボタン型リチウムバッテリを使用してください。



標準的なボタン型バッテリの交換部品番号は153099-001で、CR2032バッテリまたはそれと同等のバッテリに対応しています。



警告：ワークステーションには、リチウムマンガンダイオキシド、バナジウム五酸化物、またはアルカリバッテリもしくはバッテリパックが内蔵されています。バッテリの取り扱いを誤ると火災や破裂などの危険があるので以下のことを守ってください。

- バッテリを充電しないでください。
- バッテリを60°Cを超える場所に放置しないでください。
- バッテリを分解したり、つぶしたり、ショートさせたり、火中や水に投じたりしないでください。
- 交換用のバッテリは、必ず専用のものを使用してください。



注意：静電気の放電により、ワークステーションやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまつた静電気を放電してください。



バッテリやバッテリパックは、家庭用ゴミとして捨てないでください。バッテリパックを処分する場合は、お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、公共の収集システム等を利用して廃棄またはリサイクルしてください。

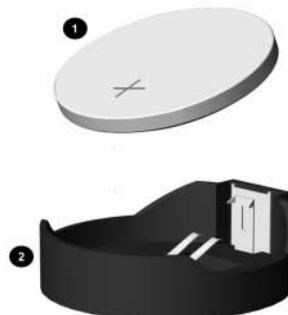
以下の手順で、バッテリを交換します。

- 適切な手順でオペレーティングシステムを終了して、ワークステーションと外部装置の電源を切り、電源コードを抜き取ってから、カバーまたはアクセスパネルを取り外します。



バッテリを交換する際に、拡張ボードを取り外す必要がある場合があります。

- 以下の図を参照して、システムボード上のバッテリ①とバッテリホルダ②の位置を確認します。



バッテリとバッテリホルダ

- リリースタブ①を押し、バッテリを上に持ち上げます②。



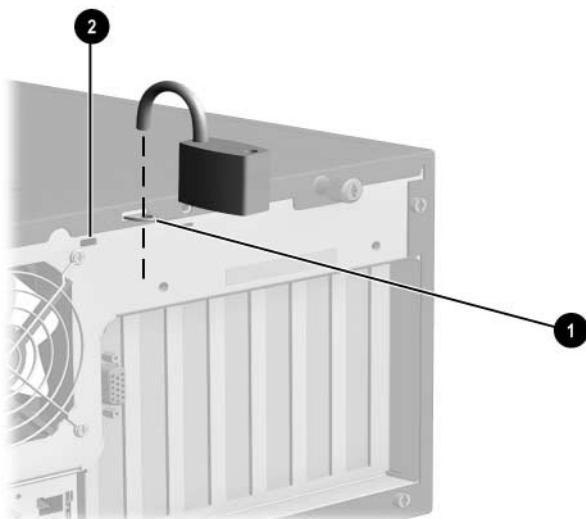
ボタン型バッテリの取り外し

4. 交換するバッテリを、"+"と書かれている面を上にして、正しい位置に装着します。バッテリ ホルダは自動的にバッテリを正しい位置に固定します。
5. 取り外した拡張ボードをすべて元のとおりに取り付けます。
6. ワークステーションのカバーまたはアクセス パネルを、元のとおりに取り付けます。
7. 電源ケーブルを元のとおりに接続し、ワークステーションの電源を入れます。
8. コンピュータ セットアップ ユーティリティを使用して、日付と時刻、パスワード、および必要なシステム設定を設定しなおします。詳しくは、Documentation Library CDに収録されている『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

セキュリティ ロック

ワークステーションの固定

お使いのワークステーションは、内部コンポーネントへのアクセスを制御するために、別売の錠①を取り付けられる設計になっています。また、ケーブルロック スロットも装備しています②。別売のケーブルロックを使用すると、ケーブルロック スロットを使ってワークステーションを固定物に固定することができます。



ワークステーションの固定

静電気対策

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システム ボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなることがあります。

静電気による損傷の防止

静電気による損傷を防ぐには、以下のことを守ってください。

- 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごとアースされている面に置きます。
- ピン、リード線、回路には触れないようにします。
- 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、つねに自分の身体に対して適切なアースを行います。

アースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち1つ以上の方法でアースを行ってください。

- すでにアースされているワークステーションまたはコンピュータのシャーシにアース バンドをつなぎます。アース バンドは柔軟な帶状のもので、アース コード内の抵抗は、 $1M\Omega \pm 10\%$ です。アースを正しく行うために、アース バンドは肌に密着させてください。
- 立って作業する場合には、かかとやつま先にアース バンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の場合には、両足にアース バンドを付けます。
- 作業用具は磁気を帯びていないものを使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットが付いた、携帯式の作業用具もあります。



上記のような、適切にアースを行うための器具がない場合、または静電気にについて詳しくは、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

ワークステーションの手入れと運搬時の注意

ワークステーションの手入れ

ワークステーションとモニタが安定して動作するよう、以下のことを守ってください。

- ワークステーションは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。また、通気が確保されるよう、ワークステーションの背面とモニタの上部に、少なくとも7~8cmの空間を確保してください。
- ワークステーションのカバーやサイドパネルを取り外したまま使用しないでください。
- 内部への通気が悪くなるので、絶対にワークステーションの正面にある通気孔をふさがないでください。キーボードをデスクトップ構成の本体のフロントパネルに立てかけることも、おやめください。
- 湿度の高い所や、直射日光の当たる場所、または極端に温度が高い場所や低い場所には置かないでください。ワークステーションを使用する際に推奨される温度範囲と湿度範囲については、このガイドの「付録A 仕様」を参照してください。
- ワークステーション本体やキーボードに液体をこぼさないでください。
- モニタ上部の通気孔は、絶対にふさがないでください。
- 以下の項目については、必ずワークステーションの電源を切り、電源コードをACコンセントから抜いてから行ってください。
 - ワークステーションやモニタの外側、キーボードの表面が汚れたら、水で湿らせた柔らかい布で汚れを落とした後、けばだたない柔かい布で拭いて乾かしてください。洗剤などを使用すると、変色や変質の原因となります。
 - ワークステーションの正面と背面の通気孔やモニタ上部の通気孔は、ときどき掃除してください。糸くずなどの異物によって通気孔がふさがれると、内部への通気が悪くなり、故障の原因となります。

CD-ROM ドライブの使用上の注意

CD-ROM ドライブの操作や手入れは、次の項目に注意して行ってください。

操作および取り扱いに関する注意

- 操作中はドライブを動かさないでください。データ読み取り中にドライブを動かすと誤動作することがあります。
- 急に温度が変化するとドライブ内に結露することがあるので気をつけてください。ドライブの電源が入っているときに急な温度変化があったときは、最低1時間待ってから電源を切ってください。すぐに操作すると、誤動作が起きことがあります。
- ドライブは高温多湿、直射日光があたる所、機械の振動がある所には置かないでください。

クリーニングの際の注意

- フロントパネルやスイッチ類が汚れたら、水で湿らせた柔らかい布で拭いてください。決して、クリーニング液を直接スプレーしないでください。
- 振発性の液体を使用しないでください。

安全にお使いいただくためのご注意

ドライブの中に、異物や液体が入ってしまった場合は、ただちにワークステーションの電源を切り、電源コードをACコンセントから抜いて、HPのサポート窓口に点検を依頼してください。

運搬時の注意

ワークステーションを運搬する場合は、以下のことを守ってください。

1. ハードディスク内のファイルのバックアップをCD、テープ カートリッジ、またはディスクケットにとります。バックアップをとったメディアは、保管中または運搬中に、電気や磁気の影響を受けないよう気をつけます。



ハードディスク ドライブは、システムの電源が切れるとき自動的にロックされます。

2. ディスクケット ドライブに入っているディスクケットを取り出します。
3. ディスクケット ドライブに空のディスクケットを挿入して、運搬中のドライブを保護します。データを保存したディスクケットや保存する予定のディスクケットは使用しないでください。
4. ワークステーションと外部装置の電源を切ります。
5. ACコンセントから電源コードを抜き取り、次にワークステーションからも抜き取ります。
6. 外部装置の電源コードをACコンセントから抜いてから、外部装置からも抜き取ります。



すべてのボードがスロットにしっかりとめ込まれていることを確認します。

7. お買い上げのときにワークステーションが入っていた箱か、同等の箱に保護材を十分に詰め、ワークステーションとキーボードやマウスなどの外部システム装置を入れて梱包します。



運搬中の環境条件については、このガイドの「付録A 仕様」の非動作時の項目を参照してください。

索引

A		
AGP		1-3
位置	2-20	1-3
コネクタ	1-3	1-3
ATXプラケット	2-21	1-6
C		
CD-ROMオーディオスイッチ	1-4	2-20
CD-ROM ドライブ、注意	F-2	2-20
D		
DIMM		1-2
取り外し	2-8	1-3
N		
NIC (ネットワーク インタフェースカード) コネクタ	1-3	1-7
P		
PCIソケットの位置	2-20	1-9
S		
[SCSISelect]	B-7	1-7
SCSIデバイス		1-3
ID	B-5	B-6
ガイドライン	B-3	B-2
U		
Ultra ATA-100ケーブル	B-2	1-10
USBコネクタ	1-3	1-14
W		
Windowsロゴキー	1-9	1-4
あ		
アースの方法	E-2	1-3
アクセスパネル		1-3
取り外し	2-3	1-3
アダプタ、ハードディスク ドライブ	2-15	1-4
アップグレード用キット	2-28	1-3
イージー アクセス キーボード		1-4
ソフトウェア	1-8	1-4
オーディオ機能		1-4
ヘッドフォンコネクタ	1-3	1-3
ラインアウトコネクタ		1-3
オーディオコネクタ		1-3
オーディオシステム		1-6
か		
ガイド用ネジ		2-13
拡張ボード		2-20
取り付け		2-20
取り外し		2-20
各部		
フロントパネル		1-2
リアパネル		1-3
キーボード		1-7
Windowsロゴキー		1-9
機能		1-7
コネクタ		1-3
ケーブル		
SCSI		B-6
Ultra ATA-100		B-2
ケーブルセレクト		B-1
ケーブルロック		D-1
構成		
デスクトップ		1-10
ミニタワー		1-14
コネクタ		
CPU電源		1-4
USB		1-3
VGA (AGP) ビデオ		1-3
カバーセンサ		1-4
キーボード		1-3
シリアルA		1-3
シリアルB		1-3
ディスクケットドライブ		1-4
電源コード		1-3
24ピン電源		1-4
パラレル		1-3
プライマリATA		1-4
フロントシャーシファン		1-4
ヘッドフォン/ラインアウト		1-3
マウス		1-3

コンポーネント		電源ランプ	1-2
ドライブ ベイ	2-9	ドライブ	2-16
取り付け手順の概要	2-1	アダプタ	2-13
さ		ドライブ取り付け用ネジ	2-13
サイドアクセス パネル	2-3	取り付け	2-14, 2-15
システム ボードの各部		取り付けの準備	2-12
CD-ROMオーディオ スイッチ	1-4	取り外し	2-17
PCIスロット	1-5	プライマリまたはセカンダリ	B-1
セカンダリ プロセッサ電圧調整モジュール (VRM)	1-5	ドライブ取り付け用ネジ	2-13
バッテリ	1-5	ドライブ ベイ	
システム ボードのコネクタ		デスクトップ構成での位置	2-11
カバー センサ	1-4	ミニタワー構成での位置	2-10
セカンダリATA	1-4	ドライブ ベイ カバー	1-13, 1-16
ディスクケット ドライブ	1-4	ドライブロック	1-14, 2-18, 2-19
電源	1-4	取り付け	
プライマリATA	1-4	拡張ボード	2-20, 2-21
フロントUSB	1-4	ドライブ	2-12, 2-15
フロントシャーシ ファン	1-4	ドライブ アダプタ	2-16
システム ボードのソケット		ヒートシンク	2-25
AGP Pro	1-5	プロセッサ	2-23
セカンダリ プロセッサ	1-4	取り付け手順の概要	2-1
プライマリ プロセッサ	1-4	取り外し	
仕様		DIMM	2-8
シリアル コネクタ	A-1	拡張ボード	2-20, 2-22
シリアル番号	1-3	サイドアクセス パネル	2-3
静電気による損傷	1-10	ドライブ ベイ カバー	1-13, 1-16, 2-12
アース	E-2	ヒートシンク	2-31
防止	E-1	フロント パネル	2-4
セカンダリ ドライブ	B-1	は	
増設	2-5	ハードウェア オプション キット、プロセッサ	2-28
メモリ		ハードディスク ドライブ	
ソケット		アダプタ	2-15
セカンダリ プロセッサ	1-4	取り付け	2-14, 2-15
プライマリ プロセッサ	1-4	取り外し	2-17
ソフトウェア		バッテリの交換	C-1, C-2
INSPECT	1-1	パラレル コネクタ	1-3
[SCSISelect]	B-7	ヒートシンク/プロセッサ	
イージー アクセス	1-8	加熱	2-29
た		分離	2-28
ターミネート、SCSIチェイン	B-4	冷却	2-28
手入れ、ワークステーション	F-1	プライマリ	1-4
デスクトップ	1-10	プライマリ ドライブ	B-1
構成	1-3	プロセッサ	
電源コード コネクタ		アップグレード	2-27

ガイドライン	2-28	メモリ	
必要なハードウェア	2-28	取り外し	2-8
アップグレード用キット	2-28		
取り付け	2-32	ら	
冷却時間	2-28	ラインアウトコネクタ	1-3
プロセッサのアップグレード	2-27	リアパネルのオーディオコネクタ	1-3
プロセッサの取り付け	2-23	ヘッドフォン	1-3
プロセッサ/ヒートシンク アセンブリ	2-25	ラインアウトオーディオ	1-3
フロントパネル		リアパネルの各部	1-3
適切な取り扱い	2-12	リアパネルのコネクタ	1-3
取り外し	2-4	AGP	1-3
フロントパネルの各部	1-2	USB	1-3
ヘッドフォンコネクタ	1-3	キーボード	1-3
ま		シリアルポート	1-3
マイクコネクタ	1-3	電源	1-3
マウス		パラレル	1-3
機能	1-10	マウス	1-3
コネクタ	1-3		
ミニタワー構成	1-14	冷却時間、プロセッサ	2-28
ミニタワーのドライブベイの位置	2-10	わ	
		ワークステーションの運搬	F-3